

個人情報の取扱いに関する同意書（応募者）

株式会社ディスパ（以下当社という）では応募者の皆様の選考・採用にあたり、個人情報を収集させて頂くことになります。収集させて頂く個人情報に関しましては、以下のような内容で管理し、保護に努めてまいります。

1. 収集する個人情報の種類

氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、国・本籍、家族関係、婚歴、職業・勤務先、役職・地位、職歴、学歴、団体加入、資格取得状況、収入、所得、課税額、納税額、公的扶助、健康状況、病歴、障害、メールアドレス、証明写真、卒業証明書、成績証明書、職務履歴簿等の情報

2. 利用目的及び取扱い

① 採否の決定

② 採用後の配属、賃金の決定及び教育、租税、社会保険等の手続き

③ ご家庭の個人情報は、ご本人と緊急の連絡をとる場合及び採用後は賃金・手当、配属先、租税、社会保険等 その他の関係法令に基づく手続き

④ 採用選考後に採用となった場合は、当社人事情報として登録させていただきます。また、不採用の場合は、提供していただいた情報は全て当社で責任を持って廃棄させていただきます。

3. 第三者への提供及び委託

法令に基づく場合を除いて、第三者へ提供することはありません。

4. 個人情報提供の際の留意点

個人情報の提供は任意とします。

提供して頂けない場合、採用応募への対応を受けられないことが有りますのでご了承ください。

5. 個人情報の問い合わせに関して

① 当社が本人の個人情報を所有している事への問合せ

② 当社が所有しているご本人の個人情報の内容の問合せ

③ 当社が所有している本人の個人情報の追加、訂正、削除のご請求 上記問合せ、ご請求先は下記にて承ります。

〈連絡先〉

株式会社 ディスパ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-5-9 精文館ビル 1F

TEL 03-6633-2377 FAX 03-6633-2378

〔管理者〕 島村 晶子

上記の内容に同意します。

令和 年 月 日

住所

氏名

印